

砥粒内包型SiCウェーハ専用CMPパッド

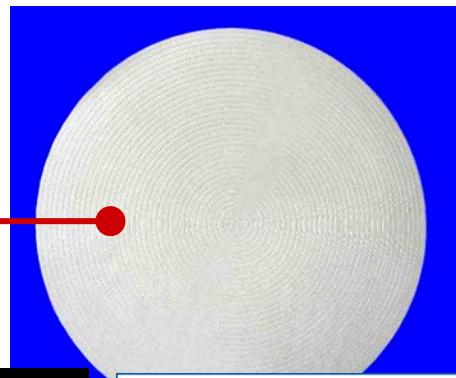
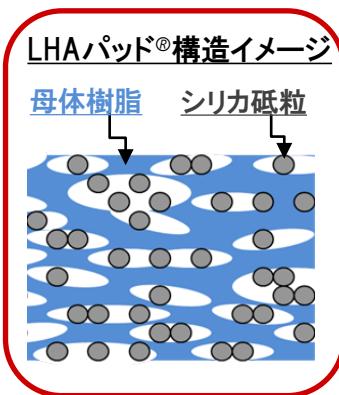
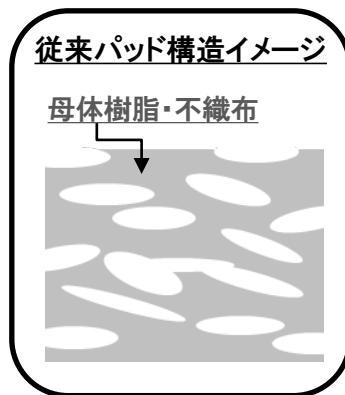
LHAパッド[®]

LHAとは Loosely Held Abrasive の略で、繊維状の母材樹脂中に、
砥粒が内包された(完全には固定されていない)構造を有する研磨工具です

特長

■ スラリー(砥粒入り研磨液)が不要

砥粒が内包されているため 研磨液のみで研磨が可能です



愛知環境賞金賞
(2022年)



日本力賞
(2020年)

■ 強酸・強アルカリ環境で使用可

耐薬品性の高い樹脂を適用したことで研磨液 pH3 ~ pH11 で使用可能です

効果

■ 加工コストと環境負荷の低減

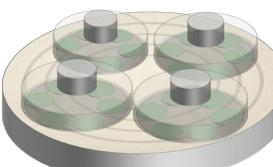
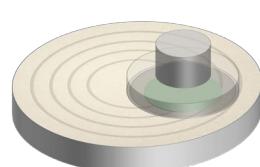
研磨液のみで研磨が可能なため ランニングコストと環境負荷の低減が可能です
耐薬品性が高いためパッドの摩耗を最小限に抑えた 長寿命工具として使用可能です

従来研磨工程との比較

	従来パッド	LHAパッド [®]
研磨イメージ	<p>スラリー(研磨液+砥粒)</p> <p>作用砥粒</p> <p>SiC</p> <p>研磨パッド</p>	<p>研磨液</p> <p>作用砥粒</p> <p>SiC</p> <p>母材樹脂</p> <p>セリヤ砥粒</p>
長時間使用	△	○
ランニングコスト・環境負荷	×～△	○

加工事例

研磨方式別加工事例

研磨方式	バッチ式	枚葉式
研磨イメージ		
定盤径(Φ mm)	1282	610
ウェーハサイズ	6インチ	8インチ
ウェーハ枚数 × ヘッド数	6 × 4	1 × 1
研磨圧(kPa)	35	40
定盤回転数(rpm)	35	120
研磨レート(μm/h)	1.8	4.1
表面粗さ(Sa nm,白色干涉)	0.12	0.14

仕様

項目	内容
外径	Φ 940mm以下（ご指定下さい） Φ 940mm < ~ ≤ 1337mm (2分割)
厚み	使用層 1.5mm (標準)
溝	<ul style="list-style-type: none"> ・同心円溝タイプ (標準) <ul style="list-style-type: none"> 溝ピッチ 1mm以上 (標準5mm) 溝幅 0.5mm or 1mm 溝深さ 0.6mm以下 ・格子溝タイプ (2分割品は格子溝のみのご提供) ・溝無しタイプ
クッション	<ul style="list-style-type: none"> ・有り (標準) ・無し
耐薬品性	pH=3~11で使用可能

ご提案可能な付随アイテム

■LHAパッド専用研磨液



■ドレッサ



ノリタケ株式会社

工業機材事業本部

[本社]

〒451-8501 名古屋市西区則武新町三丁目1番36号

TEL: 052-561-9817 FAX: 052-561-9759

E-mail: grinding@noritake.com

<https://www.noritake.co.jp/>

* 本カタログに掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので御了承ください。